



Atomic Diffusion Bonding

接合面にスパッタ成膜した薄膜が界面で原子拡散する接合技術

【特長】

- ✓ 無加熱・無加圧で接合が可能
- ✓ 超高真空プロセスによる不純物のない界面を作ることが可能
- ✓ スパッタ膜を選ぶことによって、接合界面の抵抗値や屈折率を選択可能

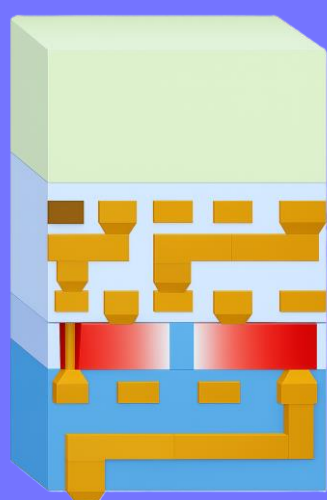
【装置性能】

	BC7000	BC7300
メカニカルスループット	≧ 15 wph	
位置合わせ精度	ウエハエッジを基準にした位置合わせ XY: ≦ 0.3 mm, θ: ≦ 0.3°	ウエハエッジを基準にした位置合わせ XY: ≦ 0.3 mm, θ: ≦ 0.3°
		Mark Alignment ≦ 1.0 μm
ウエハサイズ	100/150 mm	200/300 mm

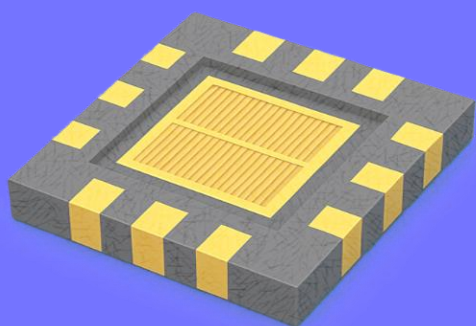
【接合用途例】

接合デバイス例

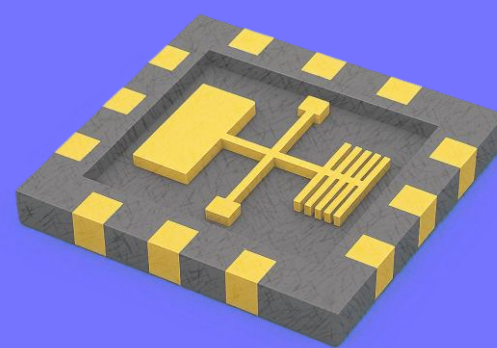
先端LSI



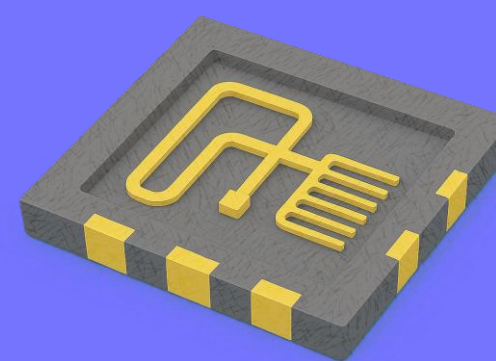
SAWデバイス



タイミングデバイス

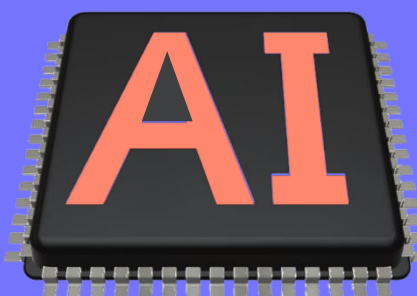


マイクロ流路デバイス



接合アプリケーション例

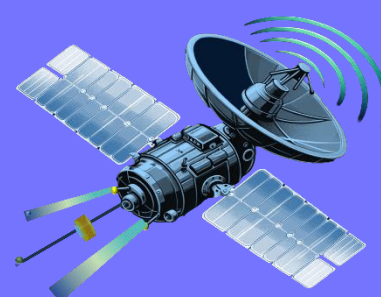
AI



携帯電話



人工衛星



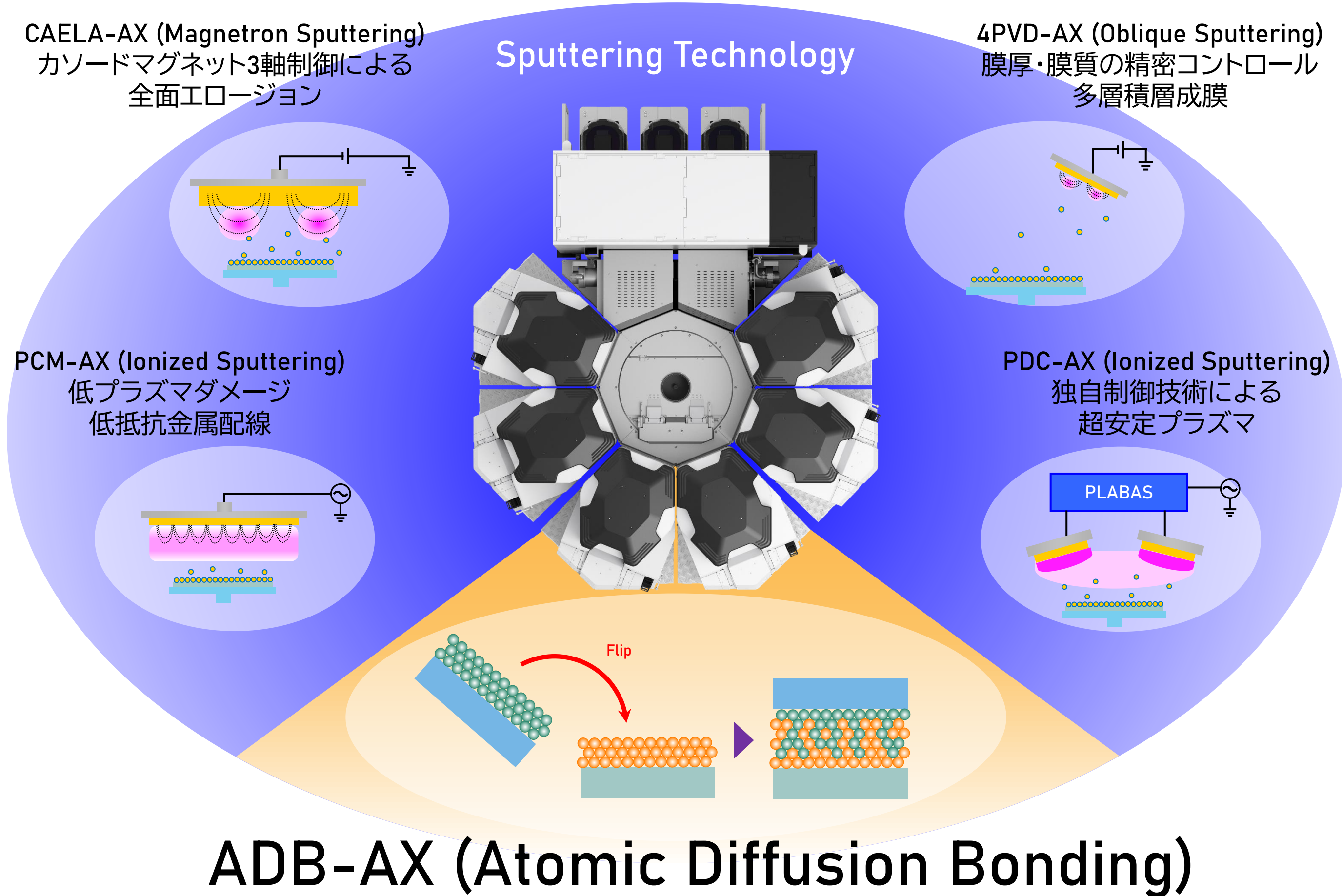
データセンター



Coming soon

ウエハ接合技術(Atomic Diffusion Bonding : ADB)が Adastra モジュールラインナップに登場

Adastra Technology Overview



Flexibility / Productivityが飛躍的に向上

- Flexibility : 接合膜成膜用スパッタリングモジュールの選択
表面処理モジュールの追加
- Productivity : スループット, フットプリントを大幅に改善